

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC (valeur crête) ou ≥ 1500 V DC selon CEI 60603

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à $+85$ °C pour une puissance maximale
- Couche d'or renforcée (30μ "") pour une protection contre la corrosion améliorée
- Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 μ " Ni / ≥ 30 μ " Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Référence	2562910000
Type	RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
GTIN (EAN)	4050118571936
Qté.	200 pièce(s)
Emballage	Tape

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	21,3 mm	Profondeur (pouces)	0,839 inch
Hauteur	17,06 mm	Hauteur (pouces)	0,672 inch
Hauteur version la plus basse	13,76 mm	Largeur	15,7 mm
Largeur (pouces)	0,618 inch	Poids net	4,575 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal	1,5 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC	Tension nominale	125 V
Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ		

Standards

Norme de connecteur	CEI 60603-7-5 1
---------------------	-----------------

Caractéristiques du système

Angle de sortie	90°	
Blindage	Oui	
Catégorie	Cat. 5	
Catégorie de puissance	Cat. 5	
Circuit	8 brins	
Cycles d'enfichage	750	
Degré de protection	IP20	
Diamètre du trou d'implantation (D)	0,9 mm	
Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45	
LED	Non	
Languettes de blindage	6 tabs	
Longueur du picot à souder (l)	3,3 mm	
Matériau de blindage	Laiton	
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/THR	
Nombre de picots par pôle	1	
Nombre de pôles	8	
Option de verrouillage	bas	
Pas en mm (P)	1,27 mm	
Pas en pouces (P)	0,05 inch	
Surface de blindage	nickelé	
Système de soudure	Soudure par refusion, Soudure manuelle, Soudure à la vague	
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	± 0,1 mm	
Tolérance sur la longueur du picot à souder	Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale)	-0,5
	Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale)	+0,5
	Tolérance, unité	mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder	+0,5 / -0,5 mm	

Date de création 7 novembre 2022 14:04:34 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

Fiche de données

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Tolérance sur la position du picot à souder	± 0,1 mm
Type de raccordement	Raccordement soudé

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 500	Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C		

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	0 m
Largeur VPE	0 m	Hauteur VPE	0 m
Diamètre de bobine du ruban ø (A)	330 mm	Résistance de la surface	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
Certificat N° (UL)	E471884
Certificat N° (cURus)	E471884

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Certificate of Compliance
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

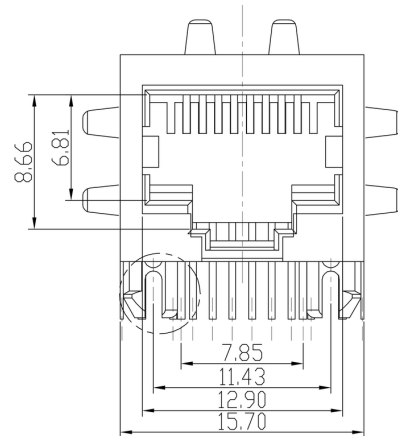
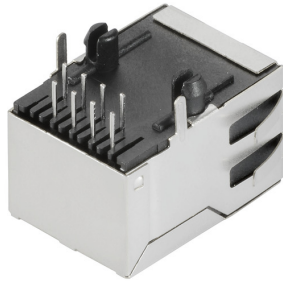
RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

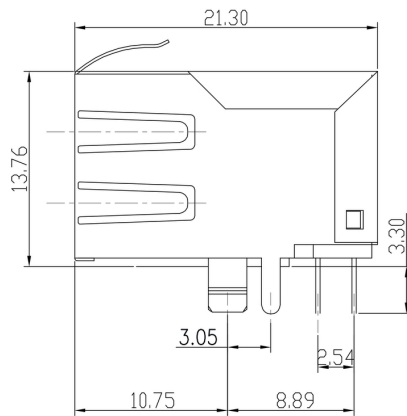
www.weidmueller.com

Dessins

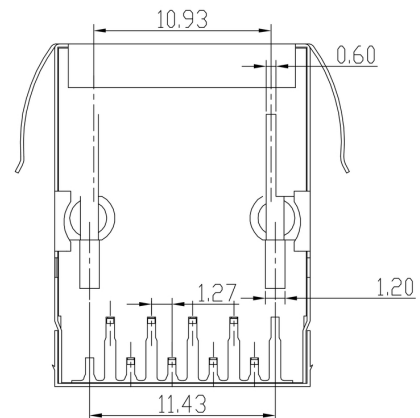
Dessin coté



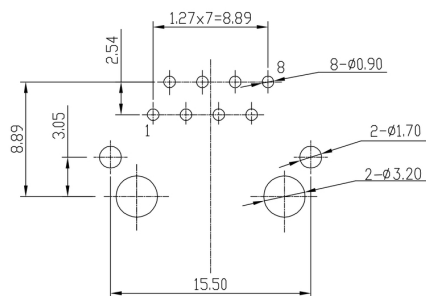
Dessin coté



Dessin coté



Conception de la plaque de circuit imprimé



PCB LAYOUT

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Code	Value	Description
RJ45	G1	RJ45G1
	R	R
	1	1
	U	U
	3.2	3.2E
	E	E
	4	4
	GY/GY	GY/GY
	TY	TY
RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY		
Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)
	RL	Tape on Reel (automated assembly)
LED	Y/G	Yellow/Green
	G/Y	Green/Yellow (standard)
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
	O/G	Orange/Green
	R/O	Red/Orange
 (further combinations possible)
	N	without LED
Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs
	N	N = without EMI tabs
Solder Pin length	3.2	3.2 mm
	1.6	1.6 mm
	D	SMD
Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down
	V	Vertical (180°, top entry)
	Y	Diagonal (45°), latch up
Number of Ports	1	1 Port
	12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport
	21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel
Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR
	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering
	S	Surface Mount Technology - SMT
	T	Soldering process: Reflow soldering
	T	Through Hole Technology - THT
	T	Soldering process: Wave
Performance Category	C5	Category 5
	C6	Category 6
	C6A	Category 6A
	C5e	Category 5e
	M	10/100 Mbit
	G1	10/100/1000 Mbit
	G10	10 Gbit
	U	Unshielded
	MP	10/100 Mbit with POE
	MP+	10/100 Mbit with POE+

Légende

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.